

1/3,AB/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

Good surface props. copper-tin alloy prodn - by vacuum melting, casting, homogenizing, annealing and hot working

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 49023127	A	19740301				197439 B

Priority Applications (No Type Date): JP 7263812 A 19720626

Abstract (Basic): JP 49023127 A

Cu-Sn Alloys having improved machinability and useful as mould materials for manu. of optical instruments (e.g., Fresnel lens) are made by vacuum melting, casting, homogenising at >700 degrees, annealing at <500 degrees, and hot working to >30% redn.

In an example, a Cu alloy contg. 6.5% Sn and 0.2% P is vacuum melted, rapidly cooled in a mould, homogenised at >700 degrees for 10-15 hrs., annealed at <500 degrees, and rolled (45% redn.) to obtain a mould (15 mm. thick) having no pin holes.



(2,000円)

特 許 願 (1)

昭和47年6月26日

特許庁長官 井 土 武 久 殿

1. 発明の名称 Cu-Sn 合金の製造方法
2. 発 明 者
住 所 東京都世田谷区宝町1-7-17
氏 名 賀 賀 正 義 (他 2 名)
3. 特許出願人
住 所 東京都大田区下丸子3-30-2
名 称 (100) キヤノン株式会社
代 表 者 御 手 洗 毅 (他 0 名)
4. 代 理 人
住 所 東京都大田区下丸子3-30-2
キヤノン株式会社内
氏 名 (0087) 井 土 丸 島 儀 一
5. 添附書類の目録

(1) 明 細 書	1 通
(2) 図 面	1 通
(3) 願 書 副 本	1 通
(4) 委 任 状	1 通

47 063812



明 細 書

1. 発明の名称

 Cu-Sn 合金の製造方法

2. 特許請求の範囲

真空中で溶解した Cu-Sn 合金を金属鋳型或いは水冷鋳型で急冷し、得られたインゴットを 700°C 以上の温度で保持して均質化処理を行った後、最終焼鈍を 500°C 以下の温度で、又、最終塑性加工を 30% 以上行う事の特徴とする Cu-Sn 合金の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は被削性の良い Cu-Sn 系合金の製造法を提供するもので特にフレネルレンズ用金型(以後金型と呼ぶ)或いは、精密微細加工及び高精度鏡面加工を施し得る極めて良好な Cu-Sn 系合金の製造法を提供するものである。

① 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 49-23127

④公開日 昭49.(1974) 3. 1

②特願昭 47-43812

②出願日 昭47.(1972) 6. 26

審査請求 未請求 (全5頁)

庁内整理番号

⑤日本分類

2116 42

10 L16

従来この種の所謂リン青銅と称されるものは、耐食性、耐疲労性が優れているため、薄板にして安価なバネ材料として使用され、又耐摩耗性が良い処から棒状、厚板状として歯車、しゅう動部品として一般に広く使用されている。又金型材料としても被削性の良い処から広く用いられている。

しかるに一般にリン青銅は大気中で溶解製造されており、そのため特に金型材に使用する 10mm 以上の厚さの材料については溶解中のガスや凝固する際の収縮率に基づくピンホールが多く、又ピンホールが小さく少ないものであつても切削加工を行つた際、切削面にマクロ的にはムラとして観察される「ムシレ」が起る。

この様なピンホール或いは「ムシレ」と呼ばれるものがリン青銅に多く表われていたが通常用いられる場合は殆んど無視出来るものであつた。

しかし、欠陥の無い鏡面の如き切削面を必要とする光学機器、精密機器、例えばフレネルレンズの金属材料として用いる様な場合、上記ピンホール「ムシレ」介在物等の欠陥はあつてはならないものである。

金型にそれ等欠陥がある場合、金型を製造する上において精度上困難を生じ、又例えば金型が出来たとしても欠陥のある表面を写し取つて出来たフレネルレンズは、光学的性質上、又カメラの商品価値の上でも好ましくない。

しかし本発明者等がフレネルレンズについて種々検討の結果ピンホール、「ムシレ」等の欠陥について、それらが各々 2μ 以下の大きさで且つ点在する程度の数であれば、実用上許容し得ることを見出した。

従つて本発明は、光学機器、精密機器等の金型

材料として実用上極めて良好に用いられ得る Cu-Sn 系合金、詳しくは「ムシレ」の無い且つピンホールを小さく少なくした Cu-Sn 系合金の製造法に関するものである。

尚本文中で「ムシレ」とは第1図Aに於いて示す如く中央にある様な切削面の乱れを言う事とする。

一般に材料が固有する被削性、即ち削られ易さを表わす場合切削作業の種類により異なるが、切削工具の寿命、切削抵抗、切削面の粗さ、切屑の状態等の要素によつて定まるが、特に金型材として例えばフレネルレンズの様な場合は第2図に示すA部即ち切削面が鏡面状に仕上ること、又B部にバリが残らない様にすることが要求される。

以下本発明を実施例に従つて詳述する。

用いた試料は成分範囲 Sn 3.0~9.5%、 P 0~0.20%、残部 Cu 及び不純物からなる Cu-Sn

た。

尚、鋳込温度は $1100^{\circ}\text{C} \sim 1300^{\circ}\text{C}$ の範囲内で湯びインゴット寸法は約 $45\text{mm} \times 180\text{mm}$ 角で最終的には 15mm の厚さの板を得た。

Cu-Sn 系合金は、平衡状態図上で固相と液相との共存する凝固範囲の広い代表的な合金であるため、凝固時に凝固フロント面に生ずる収縮巣やガスに基くピンホールは粗大になり易い。又試料中に含まれる銅はその蒸気圧が非常に高いため残留溶湯中の銅のガス濃度は高くなり、他の残留ガスと共に特に粗大なピンホールが出来易い。

これらピンホールを除くために本発明は特に真空溶解を用いるものである。

一般に溶湯中のガスを除く溶解、製造方法としては、真空溶解、真空鋳造等の方法が知られているが、りん青銅に関しては殆んど用いられていない。4字加入

系合金で代表例を第1表に示す。

第1表

試料番号	Sn	P	Cu及び不純物
1	3.0	0	Bal
2	4.1	0.23	"
3	5.5	0.08	"
4	6.5	0.20	"
5	7.0	0.16	"
6	7.9	0.25	"
7	9.1	0.30	"
8	9.5	0.10	"
9	6.1	0.16	"
10	6.6	0.18	"

上記成分の試料のうち試料1~8までは真空中で溶解し、試料9、10は比較合金として大気中で溶解し

のが現状である。

本発明に於いては、溶湯中に含まれる水素、窒素、りん等のガスを出来る限り減少せしめ、凝固後のガスに基因する2μ以上のピンホールの発生を最小限に抑える方法として真空溶解することが最も効果的であることを見出したものである。

ここで従来広く用いられている大気溶解による方法と本発明に係る真空溶解による方法とを比較しその結果を第2表に示す。該表は本発明に係る真空溶解法がピンホールを無くすために及ぼす効果を実験例で示したもので2μ以下のピンホールが点在する程度は無しとした。

又、凝固範囲が広い合金であるために生じ易い収縮巣に基づく欠陥は鑄造する際金属鑄型で必要な場合には水冷鑄型で急速に凝固させることにより等軸晶の発達を抑制し、且つ

本発明者等の検討によると金型材のもう一つの欠陥である切削面に生ずる「ムシレ」は成分が偏析している場合にも発生することが確認されている。

従つて均質化熱処理を施すことによりデンドライトの発達している鑄造組織を均一な焼鈍組織にしておくことは、金型材としては必須の条件となる。

均質化処理の後は圧延と焼鈍を必要な場合には交互にくり返し行ない、最終焼鈍は500℃以下の温度で保持時間1～2hr、最終塑性加工率は30%以上で行ない厚さ1.5mmの金型材を得た。

本発明者等は切削面に生ずる「ムシレ」の原因としては、成分偏析以外に結晶粒の結晶方向による加工性の差に基因している事を確認している。

結晶粒に基因する切削面の「ムシレ」は材料製

第2表

特開 昭49-23127(3)

試料番号	配合量 (Wt%)			溶解方法	加工率	ピンホールの分布状態
	Sn	P	Cu			
本発明合金	4	0.5	0.20	Ba1	45	無し
	5	7.0	0.18	#	15	#
比較合金	9	6.1	0.16	#	15	10μ前後のピンホール有り
	10	4.6	0.18	#	40	数μのピンホール多数有り

品出デンドライトを細かく微密にし、又固相の成長速度が速くなることで固相と液相との接触時間が短くなるため、固相から液相へのガス拡散は妨げられ、若かに残留している水素等のガスは勿論、リンに基くガスも細かく分散して強制固溶される。真空溶解し金属粉型あるいは水冷鑄型に鑄込まれたインゴットは700℃以上の温度で10～15hr充分なる均質化処理が行なわれる。

造工程の最終段階で行なわれる焼鈍及び冷間塑性加工に関係しており、焼鈍温度が高く、結晶粒が大きい場合成いは冷間塑性加工が充分でなく結晶粒が微細に破壊されていない場合に、結晶方向による加工性の差として現われる。

此処で結晶性の異なる五つの試料について塑性加工率を種々変えた時に、切削面に生ずる「ムシレ」「バリ」を調べた結果を第3表に、又、塑性加工率30%、50%の試料について、焼鈍温度を変えた時の結晶粒径の変化を図5に示す。尚、「ムシレ」に就いては2μ以下のものが点在する程度は「無し」とした。

第3表

第3表

平均(μ) 塑性加工率 (%)	10	19	27	32	45
15	□	□	□	×	×
30	○	○	○	△	△
45	○	○	○	△	△
60	○	○	○	△	△

但

○「バリ」「ムシレ」無し

□「バリ」有り

△「ムシレ」有り

×「バリ」「ムシレ」有り

この実験に於いて結晶粒が30μ以上の場合或いは結晶粒径が不均一で30μ以上の結晶粒が数多く混在している場合、被削性が損なわれない範囲で、冷間塑性加工率を上げて結晶粒を微細しても、切削面に「ムシレ」が発生することがわかった。又、冷間塑性加工率を上げると、結晶粒の大きいものでも「ムシレ」はめだたなくなる傾向にあり、又

イトにより切削し各々の面を比較したものを第1図B、Cに示す。

この結果本発明に係る合金は、被削性に富み精密微細加工及び高精度鏡面加工を施し得る、ピンホール、ムシレの無い極めて良好な、合金である事が明白である。

4. 図面の簡単な説明

第1図Aは本発明中「ムシレ」を説明する図面B、Cは本発明に係る合金と従来合金を比較した図面。第2図は、本発明に係る被削面及び「バリ」を説明する図面。第3図は、塑性加工率50、50%の試料について、焼鈍温度を変えた時の結晶粒径の変化を説明するグラフである。

出願人 キヤノン株式会社

代理人 丸 島 儀 一

特開 49-23127(4)

溶解、焼造段階で最少になる様に考慮されているピンホールやムシレは更に少なく、小さくなるが、結晶粒径の「ムシレ」に及ぼす効果及び溶解、焼造方法のピンホール、ムシレに及ぼす効果に較べると、極くわずかであり、しかも塑性加工自体60%以上になると、難かしくなるので加工率はあまり上げられない。一方塑性加工率が低い場合には「バリ」が発生し易く、15%以下では金型材として使用することは出来ない。

従つて「バリ」「ムシレ」の発生しない金型材に適した材料を製造するためには、結晶粒を30μ以下、すなわち、図3からわかるように最終焼鈍温度を500℃以下にし最終塑性加工率を30%以上にすることが極めて有効である。

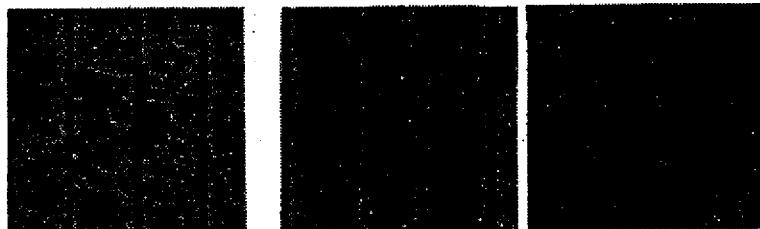
ここで第1表に示した試料のうち、本発明による合金No4と比較合金No10を各々ダイヤモンドバ

第1図

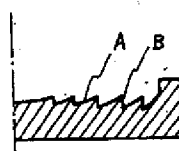
A

B

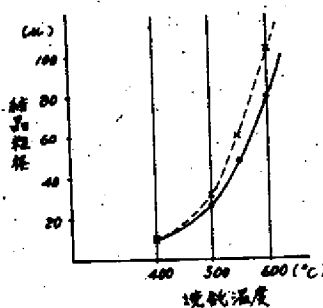
C



第2図



第3図



* 塑性加工率50%の試料について
・ 焼鈍温度300℃試料は70℃

6. 前記以外の発明者

住所 神奈川県横浜市旭区磯野台 183

氏名 福井 昌久

住所 東京都国分寺市国分寺 302-3

氏名 新見 英二